








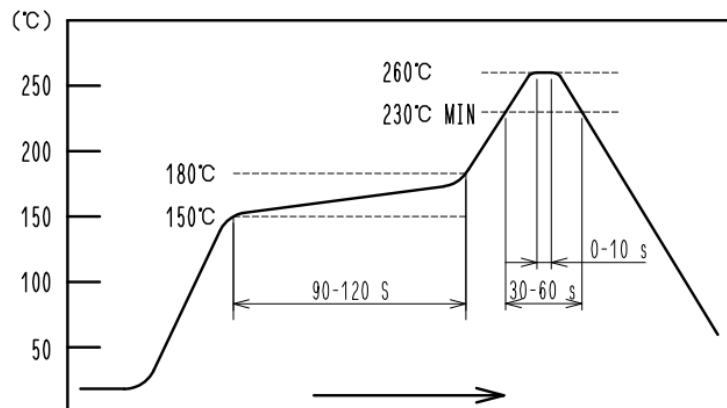


| 適用規格  |                 | IEC 61076-3-124   |   |                              |   |
|---|-----------------|---|---|------------------------------|---|
| 定格  | 使用温度範囲          | -40°C ~ +85°C (RH95% MAX 注1, 2)   | 保存温度範囲  | -30°C ~ +60°C (RH95% MAX 注1) |   |
|   | 電圧              | AC 50V / DC 60V   |   | 電流                           | 1.5 A/pin(全端子)<br>3 A/pin (端子No.1, 2, 6, 7のみ使用) |
| 性能  |                 |   |   |                              |   |
|   | 項目              | 試験方法  | 規格  | QT                           | AT  |
| 構造  | 外観, 構造, 仕上げ     | 目視, 寸法測定器にて測定する。  | 図面と合致していること。  | ○                            | ○   |
|   | 表示              | 目視にて確認する。   | 図面と合致していること。  | ○                            | ○   |
| 電氣的性能   | 接触抵抗            | 100 mA (DC OR 1000 Hz) 以下で測定する。   | 信号 : 30 mΩ 以下 (注3)<br>シールド : 100 mΩ 以下 (注3)   | ○                            | —   |
|   | 絶縁抵抗            | DC 500 V で測定する。   | 500 MΩ 以上   | ○                            | —   |
|   | 耐電圧             | DC 500 V 1分間印加。(漏洩電流 2 mA 以下)   | 絶縁破壊がないこと。  | ○                            | —   |
|   | 挿入損失 (IL)       | 1~ 500 MHz にて測定する。  | 0.02√(f) dB 以下<br>(値が0.1dB以下の場合は0.1dBとする)   | ○                            | —   |
|   | 反射損失 (RL)       | 1~ 500 MHz にて測定する。  | 68 - 20 log(f) dB 以上<br>(値が30 dB 以上の場合は30 dB とする)   | ○                            | —   |
|   | 近端漏話 (NEXT)     | 1~ 500 MHzで測定する。  | 94 - 20 log(f) dB 以上 (1 MHz~250MHz)<br>46.04 - 30 log(f/250) dB 以上<br>(250 MHz~500MHz)<br>(値が75 dB 以上の場合は75 dB とする) | ○                            | —   |
|   | 遠端漏話 (FEXT)     | 1~ 500 MHzで測定する。  | 83.1 - 20 log(f) dB 以上<br>(値が75 dB 以上の場合は75 dB とする)   | ○                            | —   |
|   | 横方向変換損 (TCL)    | 1~ 500 MHzで測定する。  | 68 - 20 log(f) dB 以上<br>(値が50 dB 以上の場合は50 dB とする)   | ○                            | —   |
|   | 横方向伝達変換損 (TCTL) | 1~ 500 MHzで測定する。  | 68 - 20 log(f) dB 以上<br>(値が50 dB 以上の場合は50 dB とする)   | ○                            | —   |
| 機械的性能   | 総合挿抜力           | 挿抜速度 : 50 mm/min 以下<br>適合コネクタで測定する。   | 差込力 25 N 以下<br>引抜き力 25 N 以下   | ○                            | —   |
|   | 繰り返し動作          | 5000 回 の抜き差しを行う。<br>挿抜速度 : 10 mm/s 以下<br>挿抜間隔 : 5 秒 以上 (未かん合状態)             | ①接触抵抗<br>信号 : 80 mΩ 以下 (注3)<br>シールド : 100 mΩ 以下 (注3)<br>②破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。                                       | ○                            | —   |
|   | 耐振性             | 周波数 10 ~ 500 Hz, 片振幅 0.35 mm,<br>加速度 50 m/s <sup>2</sup> , 3 軸向 各 2 時間試験する。 | ①1 μs 以上の電氣的瞬断がないこと。<br>(注4)<br>②破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。   | ○                            | —   |
| 注1. 結露のないこと。 注2. 使用温度範囲は通電による温度上昇も含む。<br>注3. ケーブルの導体抵抗は含まない。<br>注4. 電氣的性能については端子No3, 8を除く信号端子及びシールドに適用。 |                 |   |   |                              |   |
|   | △の数             | 訂正記事  | 設計  | 検図                           | 年月日   |
|   | 9               | DIS-E-00014487  | MT. YASUDA  | KI. KAGOTANI                 | 20231003  |
| 備考  |                 |   | 承認  | RI. TAKAYASU                 | 20180802  |
|   |                 |   | 検図  | KI. NAGANUMA                 | 20180802  |
|   |                 |   | 担当  | YS. SAKODA                   | 20180802  |
| 試験規格の記載のない試験方法は, IEC 60512(対応規格 JIS C 5402)を適用している。   |                 |   | 製図  | YS. SAKODA                   | 20180802  |
| 注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目  |                 |   | 図番  | SLC-129411-00-00             |   |
|   | 製品規格表           |   | 製品名   | IX60G-B-10P                  |   |
|   | ヒロセ電機株式会社       |   | 製品コード   | CL0251-0017-0-00             |   |

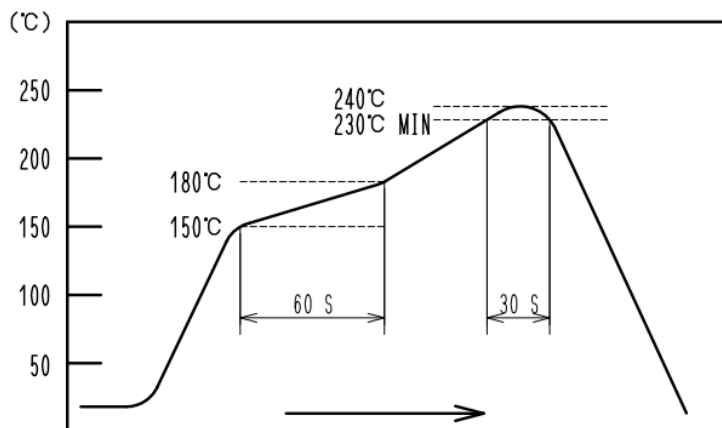
| 性   |           | 能   |  |     |
|---|-----------|---|--|-----|
| 項目  | 試験方法      | 規格  | QT AT  |     |
| 機械的性能   | 耐微摺動摩耗性   | 加速度 490 m/s <sup>2</sup> , 30 回/min の速度で 1000 回加える。   | ①1 μs 以上の電氣的瞬断がないこと。(注4)<br>②破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。  | ○ — |
|   | 耐衝撃性      | 加速度 300 m/s <sup>2</sup> , 持続時間 11 ms, 正弦半波 3 軸両方向 各 3 回衝撃を加える。(計18回)   | ①1 μs 以上の電氣的瞬断がないこと。(注4)<br>②接触抵抗<br>信号: 80 mΩ 以下 (注4)<br>シールド: 100 mΩ 以下 (注4)<br>③破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。  | ○ — |
|   | ロック強度     | 適合コネクタをかん合し、かん合軸方向に 80 N で60 秒 引張力を加える。   | ロックのはずれ及び破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。  | ○ — |
|   | ロック操作性    | 20回/min 以下の速度で 10000回 ロック操作を行う。   | ①総合挿抜力<br>差込力 25 N 以下<br>引抜力 25 N 以下<br>②破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。  | ○ — |
|   | 基板固定強度    | 適合コネクタをかん合した後、上下左右方向に適合コネクタケース端に 30 Nの力を 1 回 1 秒間、各方向 25 回 加える。   | 基板剥離及び破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。   | ○ — |
| 環境的性能   | 温度サイクル    | 温度 -55 → 常温 → +85 → 常温 °C<br>時間 30 → 2~3 → 30 → 2~3 分<br>を 10 サイクル放置する。(かん合放置)  | ①耐電圧: DC 500 V 1分間印加し(漏洩電流 2 mA 以下)、絶縁破壊がないこと。<br>②接触抵抗 <br>信号: 80 mΩ 以下 (注3)<br>シールド: 100 mΩ 以下 (注3)<br>③絶縁抵抗: 500 MΩ 以上(乾燥時)<br>④破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。   | ○ — |
|   | 温湿度サイクル   | 温度槽(低温時): 25 °C<br>温度槽(高温時): 65 °C<br>湿度: 93 %RH<br>低温槽: -10 °C<br>上記条件に 24 時間サイクル で 10 サイクル 放置する。<br>(IEC 60068-2-38, test Z / AD) | ①耐電圧: DC 500 V 1分間印加し(漏洩電流 2 mA 以下)、絶縁破壊がないこと。<br>②接触抵抗 <br>信号: 80 mΩ 以下 (注3)<br>シールド: 100 mΩ 以下 (注3)<br>③絶縁抵抗: 500 MΩ 以上(乾燥時)<br>④総合挿抜力<br>差込力 25 N 以下<br>引抜力 25 N 以下<br>⑤破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。 | ○ — |
| 注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目  |           | 図番  | SLC-129411-00-00   |     |
|  | 製品規格表     | 製品名   | IX60G-B-10P  |     |
|   | ヒロセ電機株式会社 | 製品コード   | CL0251-0017-0-00  2/4   |     |

| 性                        |  | 能   |  |                  |   |
|--------------------------|--|---|--|------------------|---|
| 項目                       | 試験方法   | 規格  | QT   | AT               |   |
| 環境<br>的<br>性<br>能        | 定常状態の耐湿性   | 温度 +40 °C, 湿度 93 %RH 中に<br>21 日間放置する。(かん合放置)  | ①耐電圧 : DC 500 V 1分間印加し(漏洩電<br>流 2 mA 以下)、絶縁破壊がないこと。<br>②接触抵抗 <br>信号 : 80 mΩ 以下 (注3)<br>シールド : 100 mΩ 以下 (注3)<br>③絶縁抵抗 : 500 MΩ 以上 (乾燥時)<br>④総合挿抜力<br>差込力 25 N 以下<br>引抜き力 25 N 以下<br>⑤破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。   | ○                | —   |
|                          | 耐熱性  | 温度 +85 ± 2 °C 中に 21日間放置する。<br>(かん合放置)   | ①耐電圧 : DC 500 V 1分間印加し(漏洩電<br>流 2 mA 以下)、絶縁破壊がないこと。<br>②接触抵抗 <br>信号 : 80 mΩ 以下 (注3)<br>シールド : 100 mΩ 以下 (注3)<br>③絶縁抵抗 : 500 MΩ 以上 (乾燥時)<br>④総合挿抜力<br>差込力 25 N 以下<br>引抜き力 25 N 以下<br>⑤破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。   | ○                | —   |
|                          | 耐寒性  | 温度 -55 ± 3 °C 中に 10日間放置する。<br>(かん合放置)   | ①耐電圧 : DC 500 V 1分間印加し(漏洩電<br>流 2 mA 以下)、絶縁破壊がないこと。<br>②接触抵抗 <br>信号 : 80 mΩ 以下 (注3)<br>シールド : 100 mΩ 以下 (注3)<br>③絶縁抵抗 : 500 MΩ 以上 (乾燥時)<br>④総合挿抜力<br>差込力 25 N 以下<br>引抜き力 25 N 以下<br>⑤破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。 | ○                | —   |
|                          | 塩水噴霧   | 濃度 5 % の塩水、試験温度 +35 ± 2 °C 中に<br>48 時間放置する。(未かん合放置)   | 端子接触部にはなはだしい腐食がないこ<br>と。   | ○                | —   |
|                          | 混合ガス試験   | 試験温度 +25 ± 1 °C、湿度 75 ± 3 %RH中<br>H <sub>2</sub> S : 10 ± 5 ppb, NO <sub>2</sub> : 200 ± 50 ppb<br>Cl <sub>2</sub> : 10 ± 5 ppb, SO <sub>2</sub> : 200 ± 20 ppb<br>にかん合状態と未かん合状態で、それぞれ 4<br>日間放置する。<br>(IEC 60512, 方法4) | ①接触抵抗<br>信号 : 80 mΩ 以下 (注3)<br>シールド : 100 mΩ 以下 (注3)<br>②破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。  | ○                | —   |
|                          | はんだ付け性   | はんだ付け部をはんだ槽 245 ± 3 °C 中に<br>3 秒間浸漬させる。<br>(Rタイプフラックスを使用のこと)  | はんだ浸漬面の 95 % 以上が新しい<br>はんだでぬれていること。  | ○                | —   |
|                          | はんだ耐熱性  | 図-1のリフロー温度プロファイルにて 2 回<br>リフローする。   | 外観の変形及び端子などに著しいガタが<br>ないこと。  | ○                | —   |
| 注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目 |  | 図番  | SLC-129411-00-00   |                  |   |
| <b>HRS</b>               | 製品規格表  |   | 製品名  | IX60G-B-10P      |   |
|                          | ヒロセ電機株式会社  |   | 製品コード  | CL0251-0017-0-00 |  3/4 |

## 性 能



△ 図-1 はんだ耐熱性プロファイル (コネクタ表面温度)



△ 図-2 推奨リフロー温度プロファイル (リード部温度)

|                          |           |                  |                  |
|--------------------------|-----------|------------------|------------------|
| 注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目 | 図番        | SLC-129411-00-00 |                  |
|                          | 製品規格表     | 製品名              | IX60G-B-10P      |
|                          | ヒロセ電機株式会社 | 製品コード            | CL0251-0017-0-00 |
|                          |           |                  | △ 4/4            |